

関東学院大学材料・表面工学研究所 論文 (1969 年度～2013 年度)

- Christopher E. J. Cordonier, Akimasa Nakamura, Daisuke Yoshioka, Kazuhiko Shimada, Akira Fujishima, Selective Plating on Photopatterned Titanium Oxide Films, Journal of The Electrochemical Society, vol.161, No.1, ppD1-D6(2014).
- Yoshiyuki Nishimura, Saori Watanabe, Katsuhiko Tashiro, Yashushi Umeda, Hideo Honma, and Tugito Yamashita, Nano-scale Smooth Interface Maintained Metallization of Polyimide Using Low Concentration Ozone Micro-nano Bubbles Dispersed in Water, JTransactions of the Institute of Metal Finishin, vol.92, No.1, pp52-58(2014).
- 富永 寛輝, 盧 柱亨, 荒川 太郎, InGaAs ポテンシャル制御量子井戸を用いた偏光無依存 2X2 光スイッチの理論検討, IEICE Technical Report, vol.113, No.186, pp147-152(2013).
- Shintaro Kashima, Joo-Hyong Noh and Taro Arakawa, Proposal of Compact Tunable 1×2 Multimode Interference Splitter Based on Multiple Quantum Well, Jpn. J. Appl. Phys., vol.52, pp04CG02(2013).
- Christopher E. J. Cordonier, Akimasa Nakamura, Daisuke Yoshioka, Kazuhiko Shimada, Akira Fujishima, A solution process for preparation of low resistance layered indium tin oxide films, Thin Solid Films, vol.534, pp529-534(2013).
- Yoshiyuki Nishimura, Mariko Maebara, Katsuhiko Tashiro, Hideo Honma, Tsugito Yamashita, Surface Morphology and Characteristics of Electroplated Au/Ni Films for Connector Contact Materials, Transactions of The Japan Institute of Electronics Packaging, vol.6, No.1, pp18-23(2013).
- 折地紗由里, 横田恭子, 田代雄彦, 梅田泰, 本間英夫, 高井治, オゾンマイクロ・ナノバブル水を用いた ABS のメタライゼーション, 表面技術協会学会誌, vol.64, No.12, pp687-689(2013).
- 西村宜幸, 鈴木慎二, 田代雄彦, 梅田泰, 山下嗣人, ラジカル水を用いた ABS 樹脂への表面改質, 日本材料科学会誌, vol.50, No.4, pp146-151(2013).

- 西村宜幸, 馬場邦人, 坂喜文, 服部康弘, 本間英夫, 山下嗣人, PTFE 粒子を分散共析させた電解スズめっき皮膜の摩擦摩耗特性, 日本材料科学会誌, vol.50, No.4, pp138-145(2013).
- 馬場邦人, 和久田陽平, 斎藤裕一, 渡辺充広, 本間英夫, ジンケート処理の代替とした粗化処理を用いたアルミニウム上への電気ニッケルめっき, 日本材料科学会誌, vol.48, pp40-45(2011).
- 西谷 伴子, 本間 英夫, 高速液体クロマトグラフィー法を利用したピアフィリング硫酸銅めっき用添加剤の濃度分析, 表面技術協会学会誌, vol.62, No.4, pp229(2011).
- 和久田陽平, 吉田康平, 田代雄彦, 本間英夫, ホウ酸フリースルファミン酸ニッケル浴から得られためっき皮膜物性, 表面技術協会学会誌, vol.62, No.2, pp131-137(2011).
- 和久田陽平, 貝塚聡, 田代雄彦, 本間英夫, 低濃度スルファミン酸浴からのニッケルめっき皮膜の特性と MEMS への応用, エレクトロニクス実装学会誌, vol.14, No.1, pp55-62(2011).
- 和久田陽平, 杉本将治, 渡辺充広, 山下嗣人, 本間英夫, 硫酸銅めっきを用いたフィリングめっき成長過程観察方法, エレクトロニクス実装学会誌, vol.14, No.1, pp63-68(2011).
- 加藤育洋, 寺島肇, 渡辺秀人, 本間英夫, 下地無電解ニッケルーリン皮膜状態がワイヤーボンディング特性に与える影響, 表面技術協会学会誌, vol.62, No.1, pp47-53(2010).
- Kunihito Baba, Yoshiyuki Nishimura, Mitsuhiro Watanabe, and Hideo Honma, Formation of Fine Circuit Patterns on Cyclo Olefin Polymer Film, エレクトロニクス実装学会誌, vol.3, No.1, pp73-77(2010).
- Ikuhiro Kato, Tomo Kato, Hajime Terashima, Hideo Watanabe, and Hideo Honma, Influences of Electroless Nickel Film Conditions on Electroless Au/Pd/Ni Wire Bondability, エレクトロニクス実装学会誌, vol.3, No.1, pp78-85(2010).
- 渡辺充広, 杉本将治, 本間英夫, 各種基材への平滑回路形成のためのめっきプロセス, エレクトロニクス実装学会誌, vol.13, No.5, pp383-387(2010).

- 馬場邦人, 西村宜幸, 渡辺充宏, 本間英夫, UV 改質を用いたシクロオレフィンポリマーフィルム上へのメタライジング, エレクトロニクス実装学会誌, vol.13, pp447-452(2010).
- 和久田陽平, 中丸弥一郎, 田代雄彦, 本間英夫, ホウ酸代替物質を使用したスルファミン酸ニッケル浴のコンポジットめっきの検討, 日本材料科学会誌, vol.47, pp185-191(2010).
- 西谷伴子, 川口明廣, 本間英夫, ダイヤモンド電極を利用する銅めっき浴用添加剤の電気化学的分析, 表面技術協会学会誌, No.8, pp-(2010).
- 中丸弥一郎, 野村太郎, 丸山貴昭, 本間英夫, 香西博明, ニッケルバンプ形状制御に用いる新規添加剤の合成とその影響, 材料の科学と工学, vol.47, No.2, pp34-38(2010).
- 中丸弥一郎, 有田匡, 田代雄彦, 山下嗣人, 本間英夫, 無電解 Ni-P 合金めっき膜中の P 偏析に及ぼす要因の検討, 材料の科学と工学, vol.46, No.6, pp242-249(2009).
- Y.Nakamaru, H.Honma, Fabrication of three-dimensional microstructure by nickel plating and photolithography, Transactions of the Institute of Metal Finishing, vol.4, No.5, pp259-263(2009).
- 中丸弥一郎, 条谷辰幸, 田代雄彦, 本間英夫, 厚付け無電解 Ni-P めっきにおけるピットやノジュール低減の検討, 表面技術協会学会誌, vol.61, No.10, pp661-667(2009).
- 杉山武晴, 馬場邦人, 渡辺充広, 本間英夫, Surface Metallization on Liquid Crystal Polymer Film by Means of UV Irradiation Reforming Process, Electrochemical Society, vol.5(2009).
- 中丸弥一郎, 金田龍馬, 清田浩之, 高橋孝, 本間英夫, 無電解めっきによるガラス上へのニッケルマスクの形成, 表面技術協会学会誌, vol.87, No.7, pp459-463(2009).
- 井上浩徳, 馬場邦人, 渡辺充広, 本間英夫, 光触媒および UV を前処理に用いた導電微粒子の作製, エレクトロニクス実装学会誌, vol.12, No.60, pp233-237(2009).

- Kotoku INOUE, Kiichi MATSUI, Mitsuhiro WATANABE, Hideo HONMA, Effect of UV irradiation on Electroless Cu-Ni-P Plating on Cycloolefin Polymer, Institute of Metal Finishing, vol.87, No.1, pp51-54(2008).
- 井上浩徳, 馬場邦人, 杉山武晴, 渡辺充広, 本間英夫, Pd 混合触媒に代わる無電解めっき用 Cu 混合触媒の検討, 表面技術協会学会誌, vol.60, No.9, pp610-614(2008).
- Kotoku INOUE, Kunihito BABA, Takeharu SUGIYAMA, Mitsuhiro WATANABE, Hideo HONMA, Evaluation of Tin-Copper Mixed Catalyst for Replacement of Tin-Palladium Mixed Catalyst for Electroless Plating, 表面技術協会学会誌, vol.3, No.9, pp610-614(2008).
- 渡辺充広, 飯森陽介, 松井貴一, 石田卓也, 杉本将治, 本間英夫, UV を用いた液晶ポリマーの表面改質, エレクトロニクス実装学会誌, No.11, pp152-156(2008).
- 中丸弥一郎, 和久田陽平, 田代雄彦, 渡辺充広, 本間英夫, ホウ酸代替物質を使用したスルファミン酸ニッケル浴から得られためっき皮膜物性とその応用, 表面技術協会学会誌, vol.59, No.2, pp51-55(2008).
- Yaichirou NAKAMARU, Yohei WAKUDA, Katsuhiko TASHIRO, Mitsuhiro WATANABE, Hideo HONMA, Physical Properties of Deposits Obtaining from Boric Acid Free Sulfamate Ni Bath, 表面技術協会学会誌, vol.59, No.59, pp51-55(2008).
- 渡辺充広, 石田卓也, 杉本将治, 水谷里志, 本間英夫, アルマイト層を利用した高熱伝導性プリント配線板, エレクトロニクス実装学会誌, vol.11, No.2, pp78-83(2008).
- Mitsuhiro WATANABE, Takuya ISHIDA, Masaharu SUGIMOTO, Satoshi MIZUTANI, Hideo HONMA, High Thermal Conductivity Printed Circuit Boards Using Anodized Aluminum Layer, Journal of Japan Institute of Electronics Packaging, vol.11, No.59, pp78-83(2008).
- Kouichi MISUMI, Atsushi YAMANOUCHI, Takahiro SENZAKI, Yasushi WASHIO, Hideo HONMA, Influence of Sputtering Conditions to Photoresist Profiles and Bump Shapes after Plating, Journal of Japan Institute of Electronics Packaging, vol.11, No.2, pp72-77(2008).

- 三隅浩一, 山之内 篤史, 先崎尊博, 鷺尾泰史, 本間英夫, スパッタ膜形成条件がフォトリソグラフィのプロファイルおよび金めっき後のバンプ形状に与える影響, エレクトロニクス実装学会誌, vol.11, No.1, pp72-77(2008).
- Yuichi SAITO, Hajime Terashima, Takeshi Muramatsu, Hideto Watanabe, Ichiro Koiwa, Hideo Honma, Effects of Ni-P Substrate Structure and Pd/Au Film Thicknesses on the Wire Bonding Strength of Electroless Au/Pd/Ni-P Films, エレクトロニクス実装学会誌, vol.11, No.1, pp53-59(2008).
- Kotoku INOUE, Kiichi MATSUI, Mitsuhiro WATANABE, Hideo HONMA, Surface Modification of Polyimide Using UV Light and Formation of Circuit Patterns, 表面技術協会学会誌, vol.1, No.1, pp47-50(2008).
- Masaharu SUGIMOTO, Toshiaki MATSUBARA, Hideo HONMA, Hiroaki KOUZAI, Effect of α , ω -Diphenylazophenoxy Polyethylene Glycol on Copper Deposition, マテリアルライフ学会誌, vol.19, No.3, pp132-135(2007).
- 小岩一郎, 足利欣哉, 渡辺充広, 本間英夫, 半導体技術を用いて作製した薄膜キャパシタの作製と基板内蔵の検討, シーエムシー出版刊 抜刷, vol.- (2007).
- 三隅浩一, 先崎尊博, 鷺尾泰史, 中丸弥一郎, 本間英夫, 電気めっき法による三次元構造体形成, エレクトロニクス実装学会誌, vol.10, No.1, pp557-559(2007).
- Koichi MISUMI, Atsushi YAMANOUCHI, Takahiro SENZAKI, Hideo HONMA, Analysis of Cross-linking Reactions for High Sensitivity and Non-antimonite Permanent Photoresist for MEMS, Journal of Photopolymer Science and Technology, vol.20, No.59, pp279-284(2007).
- 渡辺充広, 杉本将治, 本間英夫, 平滑な樹脂基板上へのメタライゼーション, 表面技術協会学会誌, No.12, pp774-778(2007).
- 配島雄樹, 杉山武晴, 小岩一郎, 本間英夫, ニオブ粒子を用いたニッケル無電解分散めっきの Ni-Nb 合金化過程, 表面技術協会学会誌, vol.7, No.11, pp691-693(2007).
- Mitsuhiro WATANABE, Hiroyuki SEIDA, Hideo HONMA, Direct Electroless Copper Plating On Glass, 表面技術協会学会誌, vol.2, No.10, pp612-614(2007).

- 配島雄樹, 斎藤裕一, 柳沢英夫, 田代雄彦, 小岩一郎, 本間英夫, 置換法におけるアルミニウム電極上へのフッ化水素酸フリーエッチング, 関東学院大学工学部 研究報告, vol.51, No.58, pp-(2007).
- 斎藤裕一, 角田貴徳, 村松 健, 渡辺秀人, 小岩一郎, 本間英夫, 無電解 Au/Pd/Ni-P 薄膜の接続特性に及ぼす Ni-P 下地層の影響, 関東学院大学工学総合研究所報, vol.35, No.58, pp-(2007).
- 渡辺充広, 松井貴一, 杉本将治, 本間英夫, シクロオレフィンポリマーへの平滑回路形成, エレクトロニクス実装学会誌, vol.10, No.58, pp229-233(2007).
- 渡辺充広, 和久田陽平, 中丸弥一郎, 田代雄彦, 本間英夫, スルファミン酸ニッケル浴中のホウ酸の代替物質に関する検討, 表面技術協会学会誌, No.5, pp317-324(2007).
- 渡辺充広, 石田卓也, 杉本将治, 小岩一郎, 本間英夫, 絶縁樹脂との接着性向上のためのアルミニウム表面粗化方法, エレクトロニクス実装学会誌, vol.10, pp135-139(2007).
- 井上浩徳, C, 小岩一郎, 本間英夫, TiO₂ 光触媒で表面改質した ABS 樹脂上への無電解 Cu めっきと Ni-P めっき界面の TEM 観察, 関東学院大学工学部 研究報告, vol.3, No.2, pp-(2007).
- 斎藤裕一, 田代雄彦, 小岩一郎, 本間英夫, ヒドラジンと次亜リン酸の混合めっき浴による微細配線上の無電解ニッケルめっき, エレクトロニクス実装学会誌, vol.58, No.1, pp62-66(2007).
- Takeshi BESSHO, Kotoku INOUE, Ichiro KOIWA, Hideo HONMA, Surface Modification of Insulation Resin for Build-up Process Using TiO₂ as a Photocatalyst and Its Application to the Metallization, Electrochemistry, vol.2, No.4, pp299-302(2006).
- 本間英夫, 小岩一郎, 光触媒を用いた低環境負荷めっき技術, 日本材料科学会, vol.43, No.3, pp129-136(2006).
- Mitsuhiro WATANABE, Ichiro KOIWA, Hideo HONMA, Kinya ASHIKAGA, Makoto TERUI, Yasushi SHIRAISHI, Noritake ANZAI, TAKESHI OHSUMI, Tetsuya OSAKA,

Tomoya KUMAGAI, Yoshimi SATO, Akira HASHIMOTO, 半導体技術を用いて作製した薄膜キャパシタの実装方法の検討, エレクトロニクス実装学会誌, vol.50, No.4, pp282-288(2006).

- Hideki HAGIWARA, Ryoichi KIMIZUKA, Hideo HONMA, Performance Evaluation of Acid Copper Plating Films for Via-Filling, Transactions of the Institute of Metal Finishing, vol.10, No.5, pp260-265(2006).
- 別所毅, 田代雄彦, 杉本将治, 本間英夫, 光触媒として TiO₂ を用いた ABS 樹脂めっきのクロムフリーエッチング代替処理, エレクトロニクス実装学会誌, vol.74, No.6, pp472-478(2006).
- Yuichi SAITO, Shuji MONONOBE, Motoichi OHTSU, Hideo HONMA, Electroless Nickel Plating under Continuous Ultrasonic Irradiation to Fabricate a Near-Field Probe Whose Metal Coat Decreases in Thickness toward the Tip, OPTICAL REVIEW, vol.9, No.4, pp225-227(2006).
- Takeshi BESSHO, Fumitaka YOSHINAGA, Kotoku INOUE, Ichiro KOIWA, Hideo HONMA, Pretreatment of Nickel Plating on ASA Resin Using Ozonated Water as Replacement for Chromic Acid Etching, 表面技術協会学会誌, vol.84, No.9, pp659-663(2006).
- Koichi MISUMI, Koji SAITO, Atsushi YAMANOUCHI, Takahiro SENZAKI, Hideo HONMA, Minute tunnel structure formation with permanent film photoresist, Journal of Photopolymer Science and Technology, vol.9, No.1, pp57-62(2006).
- 萩原秀樹, 寺島佳孝, 本間英夫, IrO₂/Ti 不溶性アノードを用いたビアフィリング用硫酸銅めっき, エレクトロニクス実装学会誌, vol.13, No.3, pp180-185(2006).
- 本間英夫, 小岩一郎, 機能性薄膜の創製とその特性 光触媒を用いた低環境負荷めっき技術, 日本材料科学会誌, vol.57, No.3, pp130-135(2006).
- 萩原秀樹, 君塚亮一, 本間英夫, フィルドビア硫酸銅めっきからの析出銅結晶の特性評価, エレクトロニクス実装学会誌, vol.19, No.2, pp113-118(2006).

- 別所毅, 井上浩徳, 小岩一郎, 本間英夫, TiO₂ を光触媒として用いたビルドアップ用絶縁樹脂の表面修飾とメタライゼーション, *Electrochemistry*, vol.9, No.4, pp299-302(2006).
- 小山田仁子, 小岩一郎, 本間英夫, 電気銅めっきによる電流波形制御を用いたビアフィリング, *Electrochemistry*, vol.43, No.3, pp212-215(2006).
- 杉本将治, 田代雄彦, 別所毅, 小岩一郎, 本間英夫, UV および TiO₂ を用いた ABS 樹脂の改質効果, *表面技術協会学会誌*, vol.9, No.2, pp162-166(2006).
- 別所毅, 井上浩徳, 石川久美子, 小岩一郎, 本間英夫, 光触媒として TiO₂ を用いたビルドアップ法による絶縁材料への無電解銅めっき, *表面技術協会学会誌*, vol.74, No.2, pp157-161(2006).
- 小岩一郎, 足利欣哉, 照井誠, 白石靖, 安在憲隆, 大角卓史, 逢坂哲彌, 熊谷智弥, 佐藤善美, 橋本亮, 半導体技術を用いた薄膜キャパシタ受動部品の作製, *エレクトロニクス実装学会誌*, vol.74, pp517-522(2005).
- Hideo Honma, Kimiko Oyamada, and Ichiro Koiwa, *Advanced Plating Technology for Electronic Devices*, *電気化学会*, vol.74, No.1, pp2 月 11 日(2005).
- 角田貴徳, 長島弘季, 西中山宏, 渡辺人, 本間英夫, ニッケルめっきの皮膜形態におよぼす直接無電解ニッケルめっき法の影響, *表面技術協会学会誌*, vol.56, No.8, pp29-33(2005).
- Kimiko OYAMADA, Ichiro KOIWA, Hideo HONMA, *Via-filling by Copper Electroplating using Stepwise Current Control*, *Electrochemistry*, vol.57, pp212-215(2005).
- 齋藤裕一, 物部秀二, 大津元一, 本間英夫, 超音波照射を用いた無電解ニッケル近接場光学プローブの作製, *表面技術協会学会誌*, vol.57, No.12, pp906-909(2005).
- 角田貴徳, 中丸弥一郎, 小岩一郎, 本間英夫, ニッケルマイクロバンプに及ぼすピリジニウムプロピルスルホネイト添加の影響, *エレクトロニクス実装学会誌*, vol.6, pp567-572(2005).

- 角田貴徳, 小岩一郎, 本間英夫, 高アスペクト比トレンチ内における無電解めっき反応の解析, 表面技術協会学会誌, vol.3, No.10, pp612-615(2005).
- 萩原秀樹, 木下泰尚, 田代雄彦, 本間英夫, 無電解銅めっきの析出形態制御, エレクトロニクス実装学会誌, vol.56, No.6, pp508-516(2005).
- 角田貴徳, 長島弘季, 西中山宏, 渡辺秀人, 本間英夫, ニッケルめっきの皮膜形態におよぼす直接無電解ニッケルめっき法の影響, 表面技術協会学会誌, vol.7, No.8, pp463-467(2005).
- Masaharu Sugimoto, Kazuki Yamaguchi, Hiroaki Kouzai, Hideo Honma, Synthesis and Practicability of Novel Additives for Copper Electroplating with Semiconductor Packaging, Journal of Applied Polymer Science, vol.56, pp837-840(2005).
- 田代雄彦, 杉本将治, 渡邊健治, , TiO₂ および UV を適用したクロムフリーABS樹脂めっき方法, エレクトロニクス実装学会誌, vol.8, No.2, pp133-139(2005).
- 岡崎克則, 渡邊健治, 加藤育洋, 森下正典, 嶋川守, , 一次乾電池用正極活物質・Ni(OH)の新しい電解合成法, Electrochemistry, vol.56, No.1, pp734-736(2004).
- Takanori Tsunoda, Toshiyuki Okabe, Hideo HONMA, Influence of the complexing agents on the thickness uniformity electroless nickel plating in the deep-recessed trenches, Journal of The Electrochemical Society, vol.96, No.10, pp610-613(2004).
- Shuji MONONOBE, Tuichi SAITO, Motoichi OHTSU, Hideo HONMA, Fabrication of a Near-Field Optical Fiber Probe Based on Electroless Nickel Plating under Ultrasonic Irradiation, Japanese Journal of Applied Physics, vol.8, No.5B, pp2862-2863(2004).
- 小山田仁子, 渡邊新吾, 西中山宏, 本間英夫, 電気銅めっきにおける添加剤のフィリング能の電析依存性, エレクトロニクス実装学会誌, vol.72, No.3, pp261-265(2004).
- 渡邊健治, 藤村翼, 西脇泰二, 田代雄彦, 本間英夫, TiO₂ 光触媒を用いたビルドアップ絶縁樹脂材料の表面改質とめっき法への応用, エレクトロニクス実装学会誌, vol.151, No.2, pp136-140(2004).

- 小山田仁子, 渡邊新吾, 西中山宏, 本間英夫, 電気めっきの電流波形制御によるビアフィリング, 表面技術協会学会誌, vol.43, No.8, pp539-541(2003).
- 山本智之, 渡辺秀人, 伊澤和彦, 本間英夫, はんだ接合強度に及ぼす無電解ニッケル-置換金めっきプロセスの影響, エレクトロニクス実装学会誌, vol.7, No.4, pp339-344(2003).
- 萩原謙, 稲葉裕之, 本間英夫, 無電解銀めっきによる導電性微粒子の作製, エレクトロニクス, vol.7, No.4, pp322-325(2003).
- 浅 富士夫, 河南 賢, 杉本怜子, 横島時彦, 門間聰之, 松田五明, 本間英夫, 逢坂哲彌, 電析ニッケルマイクロプローブの形状制御に及ぼす添加剤の構造の影響, 表面技術協会学会誌, vol.54, No.4, pp300-305(2003).
- 小山田仁子, 西中山宏, 秋山未来, 三浦修平, 本間英夫, ビアホール・スルーホール混在基板への電気銅めっき, エレクトロニクス実装学会誌, vol.6, No.3, pp228-233(2003).
- Kenichi Kataoka, Shingo Kawamura, Toshihiro Itoh, Kaoru Ishikawa, Hideo Honma, Tadatomo Suga, Electroplating Ni micro-cantilevers for low contact-force IC probing, Sensors and Actuators A 103 (2003), vol.6, pp116-121(2003).
- 石川 薫, 阿部 治, 三浦修平, 物部秀二, 大津元一, 本間英夫, 光ファイバプローブを用いた nm オーダ領域での無電解ニッケルめっきの析出挙動, エレクトロニクス実装学会誌, vol.54, No.2, pp171-176(2002).
- 田代雄彦, 大高健, 山本誠二, 橋本幸雄, 川島敏, 本間英夫, DMA Bを還元剤とした無電解Ni Bめっきの浴安定性とめっき膜のはんだ濡れ性評価, エレクトロニクス実装学会誌, vol.6, No.6, pp591-598(2002).
- 田代雄彦, 山本誠二, 橋本幸雄, 川島敏, 本間英夫, 不導体および導体上における無電解Ni Pめっきの初期析出形態, エレクトロニクス実装学会誌, No.7, pp459-465(2002).
- 田代雄彦, 山本誠二, 中里純一, 本間英夫, Distribution of Phosphorus in Electroless Nickel-phosphorous Deposits, Electrochemistry, vol.5, No.7, pp511-514(2002).

- 田代雄彦, 山本誠二, 石川薫, 中里純一, 本間英夫, 無電解 NiP めっき膜中におけるリンの分布状態, エレクトロニクス実装学会誌, vol.5, No.4, pp359-364(2002).
- 三浦修平, 三原邦明, 福士司, 本間英夫, 電気銅めっきによるビアフィリングにおける添加剤の影響, エレクトロニクス実装学会誌, vol.53, No.3, pp246-251(2002).
- 山本誠二, 代雄彦, 本間英夫, ガラス基板上への無電解 NiP めっきの初期析出挙動, 表面技術協会学会誌, vol.70, No.53, pp4(2002).
- T.nishiwaki , H.honma, Copper Metallization on Photosensitive-Crystallization Glass Surface, Plating&Surface Finishing, vol.5, No.2, pp42-46(2002).
- 田代雄彦, 山本誠二, 渡辺大樹, 本間英夫, 川島 敏, ヒドラジンを還元剤とした無電解ニッケルめっき膜の平滑化とキャップメタルへの応用, 表面技術協会学会誌, vol.5, No.1, pp71-77(2002).
- 小山田仁子, 三浦修平, 本間英夫, ULSI 配線形成におけるステップ式電解波形制御の有効性, エレクトロニクス実装学会誌, No.1, pp79-81(2002).
- 萩原謙, 川崎淳一, 大金政信, 泊慶明, 本間英夫, Co(II)錯塩を還元剤とする無電解めっきの長寿命化と光学用途に関する検討, 表面技術協会学会誌, vol.53, No.11, pp778-782(2001).
- Takeshi Kobayashi, Junichi Kawasaki, Kuniaki Mihara, Hideo Honma, Via-filling using electroplating for build-up PCBs, Electrochimica Acta, vol.47, pp85-89(2001).
- 逢坂哲彌, 浅富士夫, 阿南賢, 横島時彦, 門間聰之, 本間英夫, 高アスペクト比を有する電析 Ni マイクロプローブの試作, 表面技術協会学会誌, vol.52, No.1, pp130-134(2001).
- Shuhei MIURA, Kimiko OYAMADA, Yuichi TAKADA, , Hideo HONMA, ULSI Wiring Formation by Copper Electroplating in the Presence of Additives, Electrochemistry, vol.5, No.10, pp773-777(2001).

- 高田祐一, 石川 薫, 三浦修平, 本間英夫, ULSI 配線上への無電解ニッケルめっきによるバリアメタルの形成, エレクトロニクス実装学会誌, No.4, pp318-321(2001).
- 高田祐一, 小山田仁子, 三浦修平, 本間英夫, 電気銅めっきによる ULSI 配線形成, エレクトロニクス実装学会誌, vol.52, No.3, pp219-224(2001).
- 石川 薫, 阿部 治, 三浦修平, 本間英夫, 環境を配慮した微量スケールでの無電解ニッケルめっきの評価法, 表面技術協会学会誌, vol.69, No.3, pp303-304(2001).
- 橋本幸雄, 福原茂晴, 渡邊健治, 代雄彦, 本間英夫, 無電解ニッケルめっきの有孔度の低減と環境を配慮した評価法, 表面技術協会学会誌, vol.4, No.3, pp294-297(2001).
- 田代雄彦, 橋本幸雄, 本間英夫, 第 2 還元剤として DMAB を用いた銅ファインパターン上の選択的無電解ニッケルめっき, 表面技術協会学会誌, vol.4, No.3, pp289-293(2001).
- 西脇泰二, 本間英夫, 感光性結晶化上への銅めっき膜の形成, エレクトロニクス, vol.52, No.2, pp128-132(2001).
- 稲葉裕之, 三浦修平, 本間英夫, 無電解ニッケルめっきによるアルミニウム電極上へのバンプ形成, 表面技術協会学会誌, vol.52, No.2, pp222-227(2001).
- 逢坂哲彌, 浅 富士夫, 河南 賢, 横島時彦, 門間聰之, 本間英夫, 高アスペクト比を有する電析 Ni マイクロプローブの試作, 表面技術協会学会誌, vol.52, No.1, pp130-134(2001).
- 三浦修平, 本間英夫, マイクロファブ리케이션とめっき, 表面技術協会学会誌, vol.4, No.1, pp66-67(2001).
- Junichi Ishibashi, Takeshi Kobayashi, Hiroki Irisawa, IMPROVEMENT OF ADHESION FOR LAYER TO LAYER CONNECTION FOR BUILD-UP PRINTED CIRCUIT BOARDS, Trans. IMF, vol.52, No.4, pp140-141(2000).
- 小林 健, 川崎淳一, 三原邦昭, 山下嗣人, 本間英夫, 電気銅めっきによるビアフィリング性に及ぼす浴組成の検討, エレクトロニクス実装学会誌, vol.52, No.4, pp324-

329(2000).

- 田代雄彦, 渡辺大樹, 稲葉裕之, 本間英夫, 浴安定性に優れたヒドラジン還元剤とした無電解ニッケルめっき, 表面技術協会学会誌, vol.52, No.51, pp6(2000).
- T.Kobayashi, J.Ishibashi, S.Mononobe, M.Ohtsu, H.Honma, Electroless Nickel Plating for Nano-Fabrication in Optics, J. Electrochem. Soc, vol.78, No.3, pp1046-1049(2000).
- Junichi Ishibashi, Takeshi Kobayashi, Hideo Honma, IMPROVEMENT OF ADHESION FOR LAYER TO LAYER CONNECTION FOR BUILD-UP PRINTED CIRCUIT BOARDS, Plating and Surface Finishing, vol.3, No.3, pp76-80(2000).
- 小林 健, 石橋純一, 稲葉裕之, 物部秀二, 大津元一, 本間英夫, 微小領域への無電解ニッケルめっき, 表面技術協会学会誌, vol.147, No.51, pp2(2000).
- J.kawasaki, T.Kobayasi, K.Mihara, , H.Honma, Via-Filling using Electroplating for Build-Up Printed Circuit Boards, 196th Meeting of The Electrochemical Society, vol.87, pp51-55(1999).
- 小林健, 望月勇, 高橋秀臣, 本間英夫, Adhesion between Flat Copper Surfaces and Epoxy Insulation Resin without Roughening, 表面技術協会学会誌, vol.50, No.1, pp101-102(1999).
- H.Honma , T.Kobayashi, Micro-Fabrication Technologies on Recent Packagings, 196th Meeting of The Electrochemical Society, vol.Proceedings, pp11 月 20 日(1999).
- T.kobayasi, J.kawasaki, J.ishibasi, K..Mihara, H.Honma, Via-Filling Using Electroplating for Build-Up Printed Circuit Boards, ELECTRONIC CIRCUITS WORLD CONVENTION 8, vol.Proceedings, No.P4-5-1~P4-5-4, pp- (1999).
- H.Honma , J.ishibasi, T.kobayasi, H.Irisawa, Improvement of Adhesion Layer-to-Layer connection for Build-Up Printed Circuit Boards, ELECTRONIC CIRCUITS WORLD CONVENTION 8, vol.Proceedings, No.PO5-9-1~PO5-9-4, pp-(1999).
- Hideto.Watanabe, Shinjirou Hayashi, Hideo.Honma, Microbump Formation by Noncyanide Gold Electroplating, Journal of The Electrochemical Society, vol.Proceedings, No.146, pp2(1999).

- T.kobayasi, J.kawasaki, J.ishibasi, K.Tanaka, , H.Honma, Via-Filling Using Electroplating for Build-Up Printed Circuit Boards(1999). Fourth Annual Pan Pacific Microelectronics Symposium, vol.Proceedings, pp345-348(1999).
- J.ishibasi, T.kobayasi, T.Ichikawa, , H.Honma, Adhesion Improvement of Layer-to-Layer connection for Build-Up Printed Circuit Boards(1999). Fourth Annual Pan Pacific Microelectronics Symposium, vol.Proceedings, pp327-330(1999).
- H.Watanabe, H.Honma, TREATMENT OF COD BEARING ELECTROLESS PLATING SOLUTION BY UV IRRADIATION, Trans. IMF, vol.77, No.1, pp49-51(1999).
- Motizuki, K.Izawa, J.Watanabe, , H.Honma, PREPARATION OF ANISOTROPIC CONDUCTIVE FINE PARTICLES BY ELECTROLESS NICKEL PLATING, Trans. IMF, vol.77, No.1, pp41-43(1999).
- 小林 健, 望月 勇, 高橋秀臣, 本間英夫, 粗化处理なしの平滑銅-エポキシ樹脂の密着性, 表面技術協会学会誌, vol.50, No.1, pp101-102(1999).
- 渡辺秀人, 渡邊健治, 本間英夫, 無電解 Pd-Ni 合金におよぼす浴組成の影響, 表面技術協会学会誌, vol.50, No.1, pp63-67(1999).
- 小林 健, 川崎淳一, 石橋純一, 田中健太郎, 本間英夫, 電気銅めっきを用いた各種波形制御によるビアフィリング, 表面技術協会学会誌, vol.49, No.12, pp1332-1335(1998).
- 水口泰一, 小林 健, 藤波知之, 本間英夫, 次亜リン酸塩を還元剤とする無電解銅めっきによる導体層-絶縁樹脂層の密着性, 表面技術協会学会誌, vol.49, No.12, pp1327-1331(1998).
- 石橋純一, 小林 健, 市川卓美, 本間英夫, ビルドアップ配線板における層間接続の密着性に及ぼす諸因子について, エレクトロニクス, vol.1, No.6, pp483-488(1998).
- 石橋純一, 高田祐一, 本間英夫, 電気銅めっきによる超微細パターンの作製, 表面技術協会学会誌, vol.49, No.10, pp1130-1131(1998).

- Hideo Honma, Hideto Watanabe, Advanced Plating Technology for Electronic Packaging, AESF/SFSI Advanced Surface Technology Forum, pp73-74(1998).
- T.Fujinami & H.Honma, Electroless Copper Plating on PZT Ceramic, Plating and Surface Finishing, vol.85, No.5, pp100-103(1998).
- Seishi MASAKI, Hiroyuki INOUE, Hideo HONMA, Disolution Behavior of Silver Anode in Succinimide-Silver Complex Bath, METAL FINISHING, May-98, No.52-54, pp-(1998).
- H.WATANABE, S.ABE, H.HONMA, Gold wire bondability of electroless gold plating using disulfiteaurate complex, JOURNAL OF APPLIED ELECTROCHEMISTRY, vol.28, No.525-529, pp-(1998).
- 藤波知之, 黄顕程, 本間英夫, 無電解銅めっきによるポーラス状皮膜の形成, エレクトロニクス, vol.1, No.66, pp69(1998).
- Takeshi Kobayashi, Satoshi Itaya, Koichi Ikeda, Junichi Kawasaki, Hideo Honma, APPLICATION OF VIA POST INTERCONNECTION FOR BUILD UP PRINTED CIRCUIT BOARD(1998), IEMT/IMC Symposium, vol.Proceedings, pp312-315(1998).
- Hideto Watanabe, Hideo Honma, Direct Electroless Nickel Plating on Copper Circuits Using DMAB as a Second Reducing Agent(1998), IEMT/IMC Symposium, vol.Proceedings, pp149-153(1998).
- 望月勇, 古沢克彦, 本間英夫, ITO 上の無電解ニッケルめっき, 回路実装学会誌, vol.13, No.2, pp115-118(1998).
- 正木征史, 近藤哲也(大和化成研究所), 井上博之(大阪府立大学), 本間英夫, 非シアン浴中における銀陽極の溶解挙動, 表面技術協会学会誌, vol.49, No.3, pp320-322(1998).
- S.Abe, M.Ohkubo, T.Fujinami, H.Honma, The electroless Copper Plating of Small Via Holes, Trans. IMF, vol.76, No.1, pp12月15日(1998).
- 正木征史, 吉本雅一, 田中恵美子, 井上博之, 本間英夫, 非シアン銀メッキの密着性に

及ぼす電極近傍 pH 変化の影響, 表面技術協会学会誌, vol.49, No.2, pp201-204(1998).

- 正木征史, 吉本雅一, 井上博之, 本間英夫, ヨウ化カリウム浴からの銀メッキの電流効率に及ぼす I² の影響, 表面技術協会学会誌, vol.49, No.1, pp84-87(1998).
- Takeshi KOBAYASHI, Satoshi ITAYA, Hideo HONMA, Formation Method and Characteristics of Build Up Printed Circuit Boards with Via Post, TECHNICAL REPORT OF IEICE. CMP97-146, vol.1CD97-183(1997-12), pp57-60(1997).
- 渡辺秀人, 浅野敦, 本間英夫, 無電解めっき法によるマイクロバンプ形成, 電子情報通信学会, No.12, pp43-48(1997).
- Hideto WATANABE, Atsushi ASANO, Hideo HONMA, Fabrication of Microbumps by Electroless Plating, TECHNICAL REPORT OF IEICE. CMP97-144, vol.1CD97-181(1997-12), pp43-47(1997).
- 小林健, 阿部真二, 石橋純一, 本間英夫, 光ファイバー上への無電解めっき, 回路実装学会誌, vol.12, No.7, pp492-496(1997).
- 藤波知之, 小林健, 真庭朝夫, 本間英夫, PR 電解法によるビアフィリングの形成, 表面技術協会学会誌, vol.48, No.6, pp660-661(1997).
- 渡辺秀人, 五十嵐靖, 本間英夫, ジメチルアンミンボランを第二還元剤とする無電解ニックルめっき, 回路実装学会誌, vol.12, No.4, pp231-235(1997).
- T.Fujinami, &H.Honma, Application of Precision Filtration To an Electroless Copper Plating Bath, Plating and Surface Finishing, vol.84, No.8, pp22-23(1997).
- K.Hagiwara, J.Watanabe, H.Honma, Preparation of Anisotropic Conductive Particles By Electroless Plating, Plating and Surface Finishing, vol.84, No.4, pp74-76(1997).
- 藤波知之, 渡辺城司, 水口泰一, 本間英夫, 馬飼野信一(神奈川県産業技術総合研究所), PdCl₂/SnCl₂ 混合触媒の吸着量に及ぼすコンディショニングの効果, 回路実装学会誌, vol.12, No.5, pp160-165(1997).

- 阿部真二, 藤波知之, 青野隆之, 本間英夫, 微小ビアホールへの無電解銅めっきの均一析出性, 表面技術協会学会誌, vol.48, No.4, pp433-438(1997).
- 望月 勇, 伊澤和彦, 渡辺城司, 本間英夫, 無電解ニッケルめっきによる異方性導電微粒子の作製, 表面技術協会学会誌, vol.48, No.4, pp429-432(1997).
- H. Watanabe, H. Honma, Fabrication of Nickel Microbump on Aluminum Using Electroless Nickel Plating, Journal of The Electrochemical Society, vol.144, No.2, pp471-476(1997).
- 藤波知之, 本間英夫, 次亜リン酸塩を還元剤とする無電解銅めっきによる多層プリント配線板の内層銅箔処理, 第3回シンポジウム エレクトロニクスにおけるマイクロ接合・実装技術 論文集 , pp269-274(1997).
- 渡辺秀人, 本間英夫, 無電解ニッケルめっきによるアルミニウム上へのマイクロバンプ形成, 第3回シンポジウム エレクトロニクスにおけるマイクロ接合・実装技術 論文集 , pp29-32(1997).
- 渡辺秀人, 五十嵐靖, 本間英夫, DMAB 溶液による銅パターンの選択的活性化法, 回路実装学会誌, vol.12, No.1, pp29-33(1997).
- Hideo Honma, Hideto Watanabe, Tomoyuki Fujinami, Direct Nickel Plating on Aluminum Substrate for Microbump Formation, IMF INTERFINISH 96 WORLD CONGRESS, pp347-358(1996).
- Hideto Watanabe, Hideo HONMA, Fabrication of Nickel Microbump on Aluminum Substrate Using Electroless Nickel Plating, PCWCVII Basel, No.96, pp23-1.-23-6(1996).
- T. Fujinami, J. Watanabe, H. Honma, Catalytic Activity and Stability of Mixed PdCl₂/SnCl₂ Catalysts, Trans. IMF, vol.74, No.6, pp193-197(1996).
- H. Watanabe, H.Honma, Fabrication of Nickel Microbump on Aluminum Substrate Using Electroless Nickel Plating., Trans. IMF, vol.74, No.4, pp138-141(1996).
- 阿部真二, 西脇泰二, 渡辺秀人, 本間英夫, 亜硫酸金錯体からの無電解金めっきのワイヤーボンディング性, 表面技術協会学会誌, vol.47, No.3, pp250-255(1996).

- 萩原 謙, 渡辺城司, 本間英夫, 無電解銅めっきへの精密ろ過の応用, 表面技術協会学会誌, vol.46, No.11, pp1035-1038(1995).
- 藤波知之, 萩原 謙, 本間英夫, PZT セラミックス上への無電解銅めっき, 回路実装学会誌, No.7, pp462-466(1995).
- 渡辺秀人, 本間英夫, 無電解ニッケルめっきによるアルミニウム上へのマイクロバンプ形成, 表面技術協会学会誌, vol.46, No.10, pp946-950(1995).
- 渡辺秀人, 本間英夫, 紫外線処理による有機性汚泥指標としての COD 除去, 表面技術協会学会誌, vol.46, No.6, pp566(1995).
- H.Honma, A.Hasegawa, S.Hotta , K.Hagiwara, Electroless Gold Plating by Disulfiteaurate Complex, Plating and Surface Finishing, vol.84, No.4, pp89-92(1995).
- 藤波知之, 本間英夫, 無電解銅めっきによる針状結晶形成に及ぼす下地の影響, 回路実装学会誌, vol.10, No.4, pp244-247(1995).
- 萩原 謙, 佐藤直樹, 本間英夫, 無電解銅めっきによる導電性微粒子の作製, 回路実装学会誌 , vol.10, No.3, pp148-152(1995).
- H. HONMA, K. HAGIWARA, Fabrication of Gold Bumps Using Gold Sulfite Plating, Journal of The Electrochemical Society, vol.142, No.1, pp81-87(1995).
- H. Honma, T. Koshio, S. Hotta, H. Watanabe, Fabrication of Nickel Film on Glass Disk by Electroless Nickel Plating, Plating and Surface Finishing, vol.82, No.1, pp60-62(1995).
- H. HONMA, H. WATANABE, T. KOBAYASHI, Direct Nickel Plating on Aluminum Substrate for Micro-bump Formation, Journal of The Electrochemical Society, vol.141, No.7, pp1791-1795(1994).
- 田代雄彦, 千葉国雄, 福田 豊, 中尾英弘, 本間英夫, アルミニウム上への無電解ニッケルめっきの前処理と初期析出の関係, 表面技術協会学会誌, vol.45, No.7, pp720-725(1994).

- H. HONMA, T. KOBAYASHI, Electroless Copper Deposition Process Using Glyoxylic Acid as a Reducing Agent, Journal of The Electrochemical Society, vol.141, No.3, pp730-733(1994).
- 本間英夫, 萩原 謙, 小林 健, 無電解銅めっきの物性に影響する因子, プリント回路学会誌, vol.9, No.1, pp31-36(1994).
- 本間英夫, 斎藤彰典, 小林 健, 自己触媒型無電解はんだめっき, 表面技術協会学会誌, vol.45, No.1, pp108-109(1994).
- T.fujinami , H.honma, Surface Treatment of Copper Innerlayer with Electroless Copper Plating Using as a Reducing Agent, Proceedings of Printed Circuit World Convention P-15, pp-(1993).
- K.kobayashi , H.honma, ELECTROLESS COPPER DEPOSITION PROCESS USING GLYOXLIC ACID AS A REDUCING AGENT, Proceedings of electrochemically deposition thin film (ECS), pp344-352(1993).
- T.fujinami , H.honma, SURFACE TREATMENT OF COPPER INNERLAYER WITH ELECTROLESS COPPER PLATING USING HYPOPHOSFITE AS A REDUCING AGENT, Proceedings of 2nd International symposium in electrochemically technology (ECS), pp56-69(1993).
- 本間 英夫, 小林 健, 無電解ニッケルめっきによるアルミニウム上への直接回路形成, 表面技術協会学会誌, vol.44, No.12, pp1084-1088(1993).
- 堀田 慎一, 鈴木 佳司, 渡辺 幹男, 本間 英夫, ガラスと無電解ニッケルめっきの密着性, 表面技術協会学会誌, vol.44, No.10, pp831-835(1993).
- 小林 健, 本間 英夫, 無電解銅めっきの精密ろ過効果, 表面技術協会学会誌, vol.44, No.10, pp826-830(1993).
- Hideo HONMA, Yasunaga Kagatani, Gold Plating Using the Disulfiteaurate Complex, Journal of The Electrochemical Society, vol.140, No.9, pp135-137(1993).

- 加賀谷 康永, 本間 英夫, 亜硫酸金錯体からの金めっき, 表面技術協会学会誌, vol.44, No.7, pp638-642(1993).
- 堀田 慎一, 管野 正治, 本間 英夫, 無電解ニッケル-鉄合金めっきの浴条件と析出速度, 表面技術協会学会誌, vol.44, No.3, pp217-220(1993).
- 本間英夫, 高井英次, 小林健, 無電解はんだめっきの皮膜特性, 表面技術協会学会誌, vol.44, No.1, pp60-64(1993).
- 本間 英夫, 加賀谷 康永, 電解併用無電解めっきの電流波形と均一析出性, 表面技術協会学会誌, vol.43, No.10, pp973-977(1992).
- 本間英夫, 進藤義朗, 高木道則, 無電解 Pd-P 合金めっきと析出皮膜の特性, プリント回路学会誌, vol.7, No.4, pp263-271(1992).
- 藤波 知之, 本間 英夫, ボイドフリー無電解銅めっきの前処理について, 表面技術協会学会誌, vol.43, No.6, pp595-600(1992).
- 本間 英夫, 河内 康德, 小山田 雅明, 無電解はんだめっき, プリント回路学会誌, vol.6, No.6, pp299-305(1991).
- 本間 英夫, 小松 素明, 藤波 知之, グリオキシル酸を還元剤とする無電解銅めっき, 表面技術協会学会誌, vol.42, No.9, pp913-917(1991).
- 本間 英夫, 藤波 知之, 無電解銅めっきの異常析出現象の解析, プリント回路学会誌, vol.6, No.5, pp259-265(1991).
- 本間 英夫, 藤波 知之, 次亜リン酸塩を還元剤とする無電解銅めっきによる内層銅箔処理, プリント回路学会誌, vol.6, No.4, pp209-214(1991).
- 本間 英夫, 藤波 知之, 無電解銅めっきの均一析出性, 表面技術協会学会誌, vol.42, No.7, pp736-739(1991).
- Hideo HONMA, Masasi Noguchi, Electroless Cobalt Bath-life Extension, Plating and surface Finishing, vol.77, No.12, pp67-70(1989).

- 本間 英夫, 藤波 知之, 高木 啓明, 電解併用無電解銅めっき -プリント配線板への応用 -, 表面技術協会学会誌, vol.41, No.7, pp777-778(1989).
- Hideo Honma, Yasunori Kouchi, Direct Electroless Copper Plating On Alumina Ceramics, Plating and Surface Finishing, vol.77, No.6, pp54-58(1989).
- Kunihiko NAGATA, Hideo HONMA, Properties of PLZT Shutter with Copper Plating Electrodes, Japanese Journal of Applied Physics, vol.28, No.2, pp167-167(1989).
- 本間 英夫, 野口 雅司, 無電解ニッケルめっきの初期析出過程, 表面技術協会学会誌, vol.41, No.2, pp164-168(1990).
- 野口 雅司, 本間英夫, 亜鉛ダイキャスト上への無電解ニッケルめっき, 表面技術協会学会誌, vol.40, No.4, pp600-601(1989).
- 本間 英夫, 河内 康徳, 安田 伸一郎, アルミナセラミックス上への直接無電解銅めっき, プリント回路学会誌, vol.4, No.2, pp41-47(1989).
- 坂田 隆博, 本間 英夫, 電解併用無電解銅めっき, 表面技術協会学会誌, vol.40, No.3, pp488-489(1989).
- H. Honma, T. Komatsuzawa, ADHESION STRENGTH OF ELECTROLESS NICKEL DEPOSITS ON ALUMINA CERAMIC SUBSTRATE, ADV. MATERIALS & MANUFACTURING PROCESSES, vol.3, No.2, pp291-308(1988).
- 本間 英夫, , アルミナセラミックス上の無電解めっきの密着性, プリント回路学会誌, vol.3, No.4, pp204-211(1988).
- Hideo HONMA, Tadashi Komatsuzawa, Electroless Copper Plating on α -Alumina Ceramics, Proc. of electrodeposition of metals and alloys(1987 ECS symposium), vol.- , No.- (1987).
- Hideo HONMA, Kouno, Katsuta, Suzuki, Takatsu, Electroless Copper Plating Using CuO, Proc. of electrodeposition of metals and alloys(1987 ECS symposium), vol.- ,

No.- (1987).

- Yoshio Ootake, Hideo HONMA, NEW PRINTED WIRING BOARDS BY PARTLY ADDITIVE PROCESS, Proc of 4th Printed Circuit World Convention, vol.44-3.-44-12, No.- (1987).
- H. Homma, K. Kanemitsu, Electroless Nickel Plating on Alumina Ceramics, Plating and Surface Finishing, vol.74, No.9, pp62-67(1987).
- 渋谷 智徳, 本間 英夫, 無電解銅めっきの物性, プリント回路学会誌, vol.1, No.2, pp44-51(1986).
- 渋谷 智徳, 本間 英夫, シリコンウエハー上への無電解めっき密着性, 金属表面技術, vol.37, No.9, pp563-568(1986).
- 本間 英夫, 水島 信也, プリント基板への高延性無電解銅めっきの応用, 金属表面技術, vol.34, pp290-297(1983).
- H. Homma, A. Waku, AUTOMATIC CONTROL SYSTEM FOR HIGH SPEED ELECTROLESS COPPER PLATING, New Materials & New Processes, No.2, pp236-242(1983).
- 本間 英夫, 水島 信也, セラミックス上への無電解ニッケルめっき, 金属表面技術, vol.33, No.8, pp380-384(1982).
- Hideo Homma, Akio Waku, Automatic Control System for High Speed Electroless Copper Plating, Proceeding of the 1st AES electroless plating symposium, vol. -, No. - (1982).
- H.HOMMA, N.OHTAKE , H.MITSUI, ELECROLESS COMPOSITE PLATING, Proceeding of Inter Finish, vol.80, pp241-245(1980).
- 本間 英夫, 水島 信也, 和久 昭夫, 無電解ニッケルによる複合めっき, 金属表面技術, vol.31, No.10, pp536-540(1980).
- 本間 英夫, 水島 信也, 無電解ニッケルめっきによる微細パターン加工, 金属表面技術,

vol.31, No.2, pp91-95(1980).

- 齋藤 圃, 本間 英夫, EDTA 浴による高速度無電解銅めっきの反応機構, 金属表面技術, vol.29, No.8, pp403-408(1978).
- 齋藤 圃, 本間 英夫, EDTA 浴による高速度無電解銅めっきの延性に及ぼす添加剤の影響, 金属表面技術, vol.29, No.4, pp190-195(1978).
- 齋藤 圃, 本間 英夫, 高速度無電解銅めっき浴中の Cu(I) の挙動, 金属表面技術, vol.29, No.2, pp88-93(1978).
- 本間 英夫, , 紫外線露光による選択的無電解めっき, 日本化学会誌, vol.11, pp1614-1619(1977).
- 本間 英夫, 三井 秀雄, 阿部 裕士, ヘキサシアノ鉄(II及びIII)酸イオンの紫外線照射下における電解酸化, 日本化学会誌, vol.9, pp1400-1404(1977).
- 本間 英夫, 三井 秀雄, 水島 信也, 無電解ニッケルによる分散めっき, 金属表面技術, vol.28, No.10, pp539-540(1977).
- 本間 英夫, 福岡 由郎, 和久 昭夫, 水酸化クロムからのクロム酸の回収, 金属表面技術, vol.28, No.8, pp421-424(1977).
- 本間 英夫, 三井 秀雄, 無電解銅めっき廃液の電解酸化による COD の除去, 金属表面技術, vol.28, No.5, pp268-271(1977).
- 本間 英夫, 三井 秀雄, 小原 秀克, 無電解銅めっき液からの EDTA 回収利用, 金属表面技術, vol.27, No.4, pp195-196(1976).
- 本間 英夫, ポリプロピレン樹脂に対するプリエッチング液およびエッチング液の作用について, 金属表面技術, vol.26, No.4, pp178-181(1975).
- 本間 英夫, 植村 達夫, 重金属吸着樹脂の再生における電解法の適用, 日本工業用水協会誌, vol.181, pp18-21(1973).
- 本間 英夫, 中村 実, ABS, PP 樹脂上のエッチング機構に関する一考察, 金属表面技術,

vol.20, No.7, pp329-334(1969).